

半導体用Ptfe 8インチウェーハキャリア

ウェットクリーニング・Hf耐性エッチングカセット

商品番号: PL-CP82



前書き

高純度ウェットクリーニングおよびHFエッチングアプリケーション向けに設計された、プレミアムPTFE 8インチウェーハキャリアで、半導体プロセスを最適化します。当社の工業用フッ素樹脂カセットは、最大限の耐薬品性、卓越した耐久性、および敏感なクリーンルーム製造環境における精密な取り扱いを保証します。

詳細を学ぶ

アプリケーション	説明	主なメリット
シリコンウェーハエッチング	HF系化学液を使用した犠牲層の除去中にウェーハを取り扱います。	酸への攻撃に対する完全な耐性により、キャリアの長寿命化が保証されます。
RCAクリーニングプロセス	有機物およびイオン性不純物除去の複数の工程を通してウェーハをサポートします。	材料の純度により、洗浄された表面の再汚染を防ぎます。
CMPポストクリーニング	平坦化後に洗浄ブラシと薬液浴を通してウェーハを搬送します。	低いパーティクル発塵性により、極めて低い欠陥数を維持します。
フォトレジスト剥離	リソグラフィ後に強力な溶媒を使用して感光性コーティングを除去します。	化学的不活性性により、溶媒浴での材料劣化を防ぎます。
太陽電池製造	太陽電池（PV）セル用の高酸環境における大規模基板処理をサポートします。	大量生産における耐久性により、交換コストを削減します。
MEMS製造	複雑なウェットリリース工程中に繊細なマイクロエレクトロメカニカルシステムを管理します。	精密なスロットアライメントにより、構造物への機械的損傷を防ぎます。
分析サンプリング	高純度微量金属分析用の基板ホルダーとしてキャリアを使用します。	極めて低いバックグラウンドレベルにより、正確なラボ結果が保証されます。

機能カテゴリ	PL-CP82の技術詳細
製品識別	PL-CP82シリーズ カスタムウェーハキャリア
主材料	高純度バージンPTFE（ポリテトラフルオロエチレン）
対応ウェーハサイズ	標準8インチ（200mm）/ 完全カスタマイズ可能な直径
構成タイプ	単枚ウェーハ（個別）またはマルチスロット対応
製造方法	100%精密CNC加工（成形残留物なし）
温度範囲	-200°C～+260°C（-328°F～+500°F）
耐薬品性	汎用（HF、HCl、H2SO4、KOH、アセトンなど）
表面粗さ	特定のクリーンルーム要件に基づきカスタマイズ可能

機能カテゴリ	PL-CP82の技術詳細
スロットピッチ/深さ	クライアント固有のプロセスパラメータに合わせて調整
ハンドル/インターフェース	カスタムロボットピックアップポイントまたは手動グリップオプション
寸法精度	工業規格に準拠した高精度公差制御